

● 特性

- I 薄膜技术
- II 膜层钝化树脂保护
- III 高精度 (0.05%)
- IV 低噪声

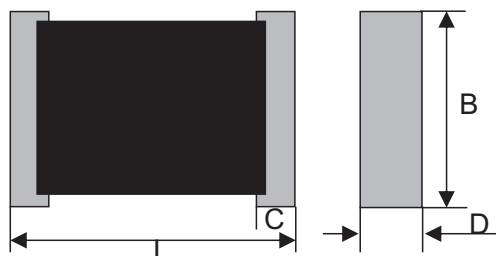
● 应用

RMK型产品为无引线结构，以金层做为端电极的底层表面电镀镍及锡铅，确保阻值稳定性及焊点可靠度，具有体积小、重量轻、性能优越、质量可靠等特点广泛应用于航空、航天、船舶、雷达、通讯、自动控制等重要军工领域。

● 参考规格

JISC 5201-1

● 尺寸图

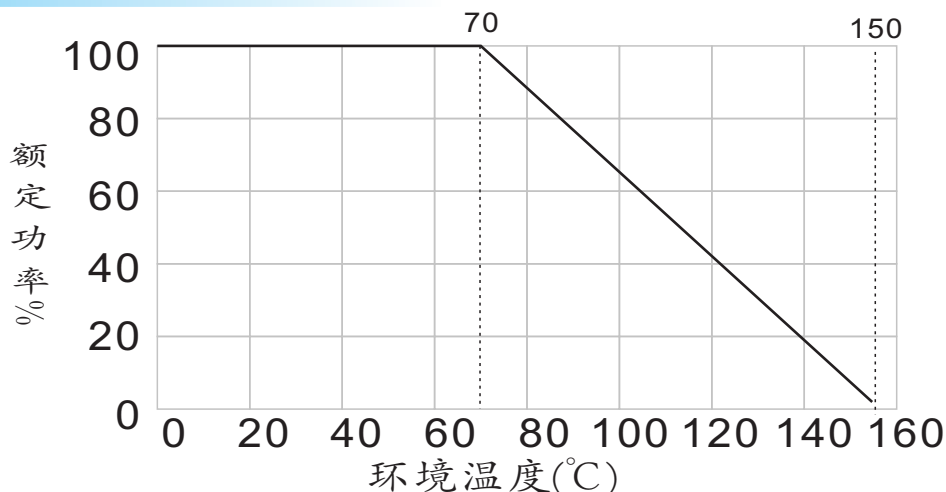


型号	L	B	D	C	
RMK	1608	1.60 ± 0.20	0.80 ± 0.13	0.40 ± 0.15	0.30 ± 0.20
	2012	2.00 ± 0.20	1.25 ± 0.13	0.50 ± 0.15	0.40 ± 0.20
	3216	3.20 ± 0.20	1.60 ± 0.13	0.50 ± 0.15	0.50 ± 0.20
	3225	3.20 ± 0.20	2.50 ± 0.15	0.50 ± 0.15	0.50 ± 0.20

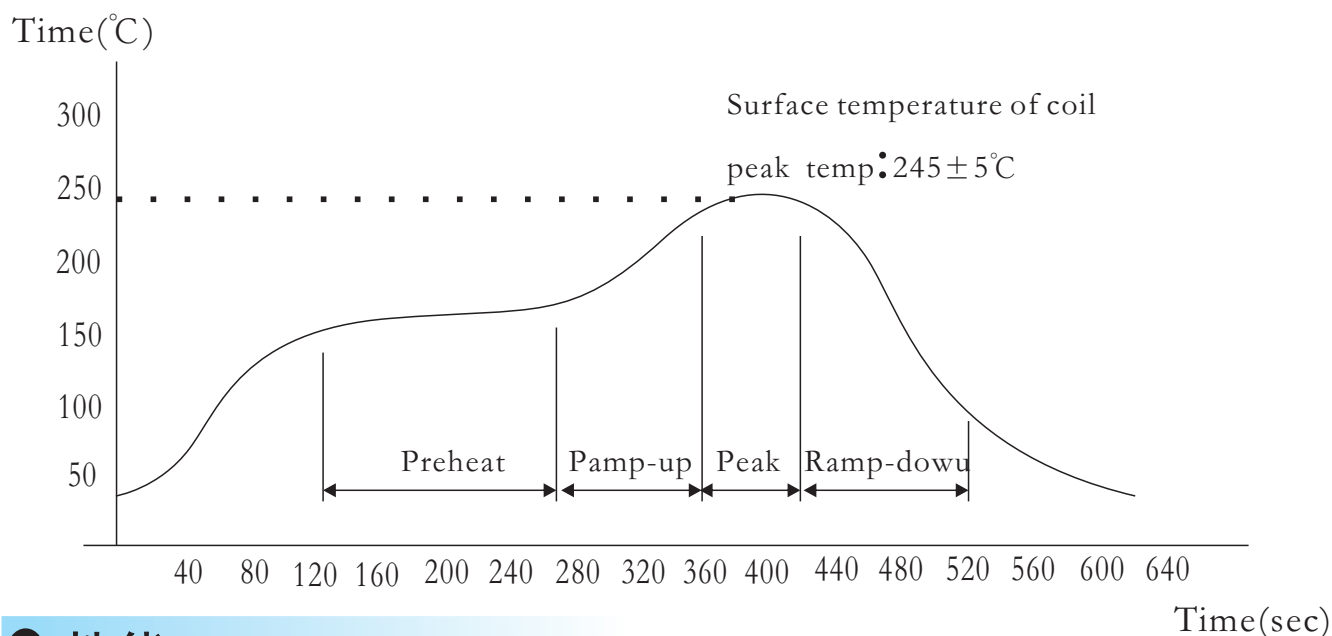
● 功率、阻值范围与耐电压

型号	70°C 额定功率(W)	阻值范围(Ω)	最高使用电压(V)	精度范围	失效率等级
RMK1608	0.1W	10R~260K	50V	F=±1%, D=±0.5%, C=±0.25%, B=±0.1%, W=±0.05%,	五级
RMK2012	0.15W	10R~510K	50V		
RMK3216	0.25W	10R~1M	100V		
RMK3225	0.5W	10R~1M	150V		

● 额定温度下降曲线图



● 表面贴装电阻回流焊接曲线图



● 性能

试验项目	特性 T.C.R		Test Method
	±25ppm/°C	±50ppm/°C	
过载	$\Delta R \leq \pm(0.10\%R+0.01\Omega)$	$\Delta R \leq \pm(0.10\%R+0.01\Omega)$	2.5倍额定电压,不超过2倍元件极限电压,持续5S
温度冲击	$\Delta R \leq \pm(0.10\%R+0.05\Omega)$	$\Delta R \leq \pm(0.25\%R+0.05\Omega)$	-65°C~150°C, 10次循环
低温工作	$\Delta R \leq \pm(0.10\%R+0.05\Omega)$	$\Delta R \leq \pm(0.25\%R+0.05\Omega)$	-65°C, 额定负荷电压45min
高温暴露	$\Delta R \leq \pm(0.10\%R+0.01\Omega)$	$\Delta R \leq \pm(0.20\%R+0.01\Omega)$	150°C 下保存100小时
耐焊接热	$\Delta R \leq \pm(0.20\%R+0.05\Omega)$	$\Delta R \leq \pm(0.25\%R+0.05\Omega)$	245±5°C, 60±5s
耐潮湿	$\Delta R \leq \pm(0.20\%R+0.05\Omega)$	$\Delta R \leq \pm(0.40\%R+0.05\Omega)$	10个循环
寿命	$\Delta R \leq \pm(0.50\%R+0.05\Omega)$	$\Delta R \leq \pm(0.50\%R+0.05\Omega)$	70°C 额定负荷, 2000h

● 料号编号

RMK	1608	F	10R00	T
产品名称	功率	精度	阻值	包装形式
有失效率等级的片式薄膜电阻器	1608=0.1W 2012=0.15W 3216=0.25W 3225=0.5W	F=±1%, D=±0.5%, C=±0.25%, B=±0.1%, W=±0.05%	10R00=10Ω 10K00=10KΩ 1M00=1MΩ	T:编带包装 B:袋式包装